立即发布

YINCAE 推出创新型底部填充胶 UF 120HA-10

通过 10 次 260°C 高温回流测试，低温固化、免清洗，助力先进半导体封装

美国纽约，2026 年 11 月 13 日 — 先进半导体封装材料研发与制造商 YINCAE 正式推出新一代高性能底部填充胶 UF 120HA-10。该产品结合低热膨胀系数（CTE）、低温固化及助焊剂残留兼容性等技术优势，旨在降低热机械应力、简化制造工艺并提升封装可靠性，为下一代先进半导体封装提供创新材料解决方案。

随着人工智能（AI）、高性能计算（HPC）及先进封装技术快速发展，芯片封装对材料性能、工艺效率和长期可靠性提出了更高要求。UF 120HA-10 针对这些需求而开发，帮助制造商优化生产流程并降低制造成本。

六大核心技术优势

- **低 CTE，降低热机械应力**：减少芯片、基板及互连结构之间因热膨胀不匹配产生的应力，提高封装耐久性。
- **通过 10 次 260°C 高温回流测试**：展现优异的热稳定性和耐高温回流性能，满足复杂封装工艺需求。
- **低温固化，优化生产工艺**：降低器件在封装过程中的热负荷，提高工艺灵活性。
- **兼容助焊剂残留，简化清洗**：在兼容的助焊剂体系及组装工艺条件下，可省去单独的清洗步骤，缩短生产周期并降低成本。
- **高可靠性，适应严苛环境**：有助于增强封装结构稳定性，满足高性能半导体器件的可靠性需求。
- **应用灵活，支持多种封装技术**：可用于传统及先进半导体封装工艺的材料评估。

面向 AI、GPU、HBM 及 2.5D/3D 先进封装

UF 120HA-10 面向人工智能处理器、GPU、高性能计算、倒装芯片（Flip-Chip）、先进 2.5D/3D 封装、高带宽存储器（HBM）、汽车电子、移动设备及光电子等应用领域的材料评估，为高密度、高性能半导体封装提供材料支持。

YINCAE：以创新材料技术推动半导体封装发展

YINCAE 表示：“UF 120HA-10 将高可靠性与简化制造工艺相结合，为半导体制造商提供灵活、高性能的底部填充材料解决方案，助力下一代先进封装技术发展。”

关于 YINCAE

YINCAE 是一家高性能半导体封装材料研发与制造企业，主要产品包括底部填充胶（Underfill）、封装保护材料（Encapsulants）、芯片粘接胶（Die Attach Adhesives）及热界面材料（TIM）。公司致力于通过材料创新提升半导体器件的可靠性、性能及制造效率。欢迎半导体封装企业、研发机构及电子制造商联系 YINCAE，获取 UF 120HA-10 技术资料、样品评估及应用支持。

www.yincae.com | info@yincae.com |